특 집

'94년도 전자산업 경기전망 세미나

'94 일반전자부품산업 전망

김시균/삼성전기(주) 전무

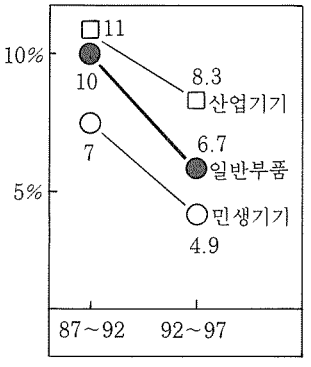
1. 일반 전자부품 환경분석

일반 전자부품의 향후 5년간 연평균 성장률은 과거 10%대에서 6.7%정도로 낮아질 것으로 전망된다.

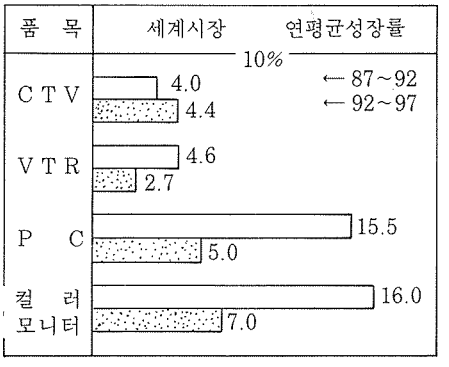
그러나 '94년에는 컴퓨터 및 첨단정보가 전부문의 성장에 힘입어 캠코더, PC, 컬러 모니터, 이동체 통신기기 등 관련부품은 고성장이 예상되고 컬러 TV, VCR, 카세트, 전자레인지 등 가전제품관련 부품산업은 저성장 국면으로 접어들 전망이다.

특히 일본업체들이 진출해 있는 아세안국가들을 중심으로 이미 세계적 부품공급기지화가 이루어지는 등 외부 환경이 국내 업체들에게 마이너스 요인으로 작용하고 있지만 정부의 신경제 정책의 일환으로 추진하고 있는 소재·부품산업 육성은 플러스효과로 나타날 것으로 예상된다.

〈향후 5년간 성장전망〉 〈참고 : 주요세트 성장전망〉

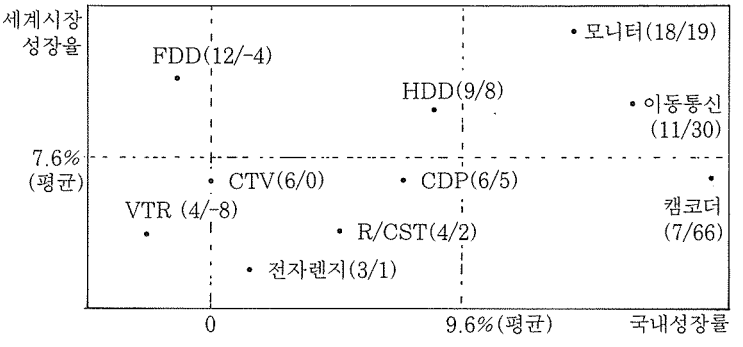


(자료 : EIAJ, '92)



(자료 : EIAJ, '93)

〈세계 · 국내성장률 MATRIX〉 (94년 성장률 : 세계/국내)



2. '94 일반부품 시장 전망

'94년도 일반부품의 세계시장 규모는 올해 마이너스 11%(8백 62억달러)에서 벗어나 3% 정도 늘어난 889억 달러로 예측된다.

품목별로는 영상부품중 DY(편향 코일), FBT(고압 변성기) 등 디스플레이 부품이 올해 3.9% 성장에서 내년에는 7.0%로 증가되고 고주파 부품(전자식 튜너)은 1.8%에서 5.2%로, 드럼·헤드 등 VCR부품은 0.6%에서 4.6%으로 성장할 것으로 보인다.

SMPS(전원공급장치) 등 PC 부품은 올해 13.1%에서 16.2%로 성장이 예측되고 스피커, 데크 등 음향부품은 0.2%에서 3.5%로 늘어나고 범용부품중 콘덴서는 6.0%에서 7.6%, 다층 PCB(MLB)는 8.0%로 성장하는 등 세계 일반부품시장이 확대될 것으로 전망된다.

국내 일반부품시장은 수출회복세에 힘입어 호전될 전망이다.

일반부품도 올해 8% 증가한 5조 1,800억원에서 내년에는 전년대비 10% 증가한 5조 7,000억원에 이를 것으로 예측된다.

국내 일반부품의 생산·수출 전망을 보면 영상부품 및 칩부품, PCB, 소형모터 등은 호조가 예상되는 반면 스피커, 오디오헤드 등 음향부품은 부진할 것으로 전망된다.

3. 기술 및 제품 전망

세트의 다운 사이징화 및 개인정보화, 정보가전(종합화), 디지틀화 경향에 따라 전자부품은 소형·박판화와 경량화, SMD 및 SMT화, 복합부품(모듈화)화가 급진되고 노이즈 대책 부품산업이 활성화될 것으로 보인다.

특히 그동안 전자 부품이 세트의 설계·개발동향에 크게 좌우돼 왔으나 앞으로는 전자부품의 기술혁신이 세트 발전에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.

또한 칩화가 진전되면서 모듈화로의 이행이 가속화될 전망이다.

최근 1005타입의 초소형 MLCC가 개발됐지만 칩 장착기술의 한계로 실제 부품채용이 어려워 부품의 모듈화를 꾀하고 있다.

4. 기업과 정부의 역할

이에 따라 국내 부품업계는 지금 사업의 재구축이 절실히 요구

경쟁국의 부품생산규모 (억엔, %)

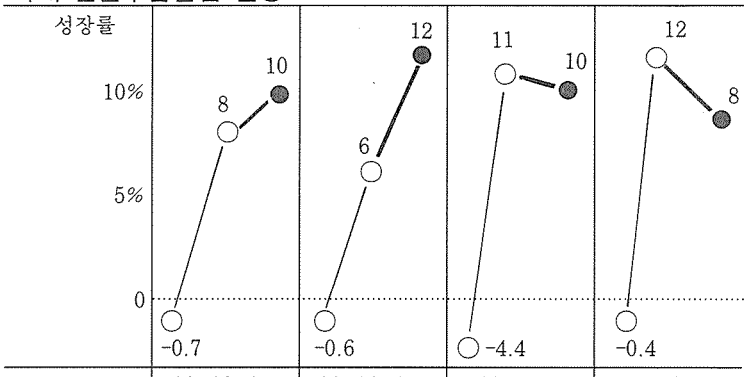
품 목	한 국	대 만	태 국	말 련	싱가폴
전해콘덴서	364	135(77)	35(10)	140(38)	120(33)
세라믹콘덴서	107	209(195)	45(42)	70(65)	84(79)
고정저항기	141	151(107)	—	103(73)	46(33)
Trans	110	178(162)	111(101)	130(118)	8(90)
Switch	278	89(32)	21(8)	77(28)	8(3)
스피커	230	60(60)	60(26)	—	122(49)
소형모타	152	59(39)	300(197)	250(165)	330(217)
자기Head	600	22(4)	31(5)	90(15)	40(7)
스위칭전원	155	88(57)	28(18)	300(194)	210(136)

주 1. 상단 5품목은 93년, 하단 4품목은 92년 기준
2. ( )는 한국=100을 기준한 비교치

주요 부품별 성장전망

품 목		세계시장 성장율(%) 0 10 20	시 장 동 향
영상부품	Display 부품 (DY, FBT)	3.9 ← 93 7.0 ← 94	• 엔고→일본시장 진출호기 • 대만업계의 저가 공세
	고주파 부품 (전자식튜너)	1.8 5.2	• EC, NAFTA→부품현지화요구 • 남미경기 회복→수요증가
	VTR부품 (Drum, Head)	0.6 4.6	• 엔고→일본 세트업계의 해외 부품조달 확대
PC부품	SMPS	13.1 16.2	• 대형 Buyer들이 한국으로 구매선 전환 • 세트업계의 가격인하압력 가중
음향	스피커 DECK	0.2 3.5	• 엔고→일본시장 진출호기 • 중국, ASEAN의 저가공세
범용부품	콘덴서	6.0 7.6	• 칩화율 확대 : 연 15% 증가 • 소량다기종, 단납기 요구
	MLB	8.0 10.8	• 이동통신분야 수요 확대 • 가격전쟁 심화(연 3~5% 인하)

국내 일반부품산업 전망



구 분	92 93 94	92 93 94	92 93 94	92 93 94
	생 산	수 출	로 칼	내 수
92년	480백억원	27.9억$	18.0억$	95백억원
93년	518	29.6	20.0	106
94년	570	33.2	22.0	118

주) 1. EIAK자료로부터 삼성전기가 작성
2. 반도체와 브라운관을 제외한 「일반부품」만 포함

국내 일반부품의 생산 · 수출 전망

		생 산 (억원)		수 출 (백만$)	
		93년 예상	94년 전망	93년 예상	94년 전망
영상 부품	전자식튜너	2,250(12)	2,587(15)	65(10)	73(14)
	D Y	1,234(23)	1,542(25)	35(28)	45(30)
	Video Head	797(59)	956(20)	36(-20)	40(10)
음향 부품	스 피 커	1,526(-14)	1,420(-7)	170(-13)	161(-5)
	Audio Head	105(-40)	84(-20)	4(70)	5(25)
범용 부품	콘 덴 서	4,685(18)	5,622(20)	178(16)	210(18)
	-전 해	2,360(14)	2,690(18)	64(6)	70(10)
	-세 라 믹	788(60)	906(15)	29(95)	43(50)
	칩 부 품				
	-M L C C	232(45)	348(50)	7.5(61)	10.5(40)
	-탄 탈	67(11)	77(15)	3.9(11)	4.3(10)
	-칩 저 항	158(32)	190(20)	4.1(40)	5.3(30)
	P C B	4,975(31)	6,467(30)	229(31)	264(35)
	소 형 모 타	2,352(48)	3,057(30)	98(-1)	108(10)

주) 1. EIAK 자료로부터 삼성전기가 작성
2. ( )는 전년비 증감율로 %임.

일본의 콘덴서 칩화율

(%)

콘덴서 칩화율	'89년	'93년	'94년 예측
세라믹콘덴서	62	75	84
탄탈콘덴서	59	70	81
전해콘덴서	3	14	19
필름콘덴서	2	7	10

되는 시기로 사업품목의 고도화와 함께 해외생산 확대, 철저한 합리화가 요구되고 있다.

현재 국내 부품업체는 박리다매의 제품생산 · 판매구조에다 소재기술 및 자금력이 극히 취약한 현실을 감안, 일본과 같이 차세대 유망부품을 강화하고 소재부터 부품까지 일괄생산하는 사업품목다양화와 고도화가 요망된다.

또 해외생산은 일부 전문업체 중심으로 중국, 동남아로 진출, 아직 초보단계에 있는 해외생산 비율을 확대해야 하고 철저한 합리화를 통해 품질을 높이고 간접인력의 비중을 낮추고 조직운영을 효율적으로 관리해야 한다.

정부는 장기적이고 종합적인 일반부품 육성정책을 펴야하며 부품국산화 및 인력양성에 대한 지원을 대폭 강화해야 할 것이다.